科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 2 8 年 6 月 1 日現在

機関番号: 17102

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2013~2015

課題番号: 25420712

研究課題名(和文)窒化アルミニウム粉末を原料とする窒化アルミニウム単結晶成長技術の開発

研究課題名(英文)Development of AIN growth method using AIN powder

研究代表者

寒川 義裕 (Kangawa, Yoshihiro)

九州大学・応用力学研究所・准教授

研究者番号:90327320

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,100,000円

研究成果の概要(和文):都市生活を営む上で直流 - 交流変換などの電力変換は不可欠である。本研究では、高品質かつ低コストのAIN 単結晶基板の成長技術を確立し、次世代AIN 系パワーデバイス開発の加速に貢献することを目的とする。目的達成に向けて、AIN固体ソース溶液成長中の高温固 - 液界面のその場観察装置を開発し、成長初期過程の観察を行った。成長温度1250 では樹脂状成長様式が、1350 では多段ステップの移動による成長様式が観察された。得られたAINは多結晶であったが、高温固 - 液界面のその場観察技術の開発およびAIN固体ソース溶液成長プロセスの解明に成功した。

研究成果の概要(英文): Aluminum nitride (AIN) and related compound semiconductors, such as AlGaN, have attracted much attention because of their great potential as power devices. Interfacial phenomena at the liquid/solid interface under high temperatures were observed in real time to understand the growth process of AIN during solid-source solution growth. In this study, we used transparent substrate, i.e., AIN/sapphire template, so as to observe high-temperature liquid/solid interfaces through the substrate from the bottom. Though a poly-crystal formed because of melt-back etching during the initial stage of growth; nevertheless, initial growth process was successfully observed by the in-situ observation system. This in-situ observation system could be a powerful tool for investigating interfacial phenomena at high-temperature liquid/solid interfaces and optimizing crystal growth conditions.

研究分野: 半導体結晶成長

キーワード: 溶液成長 窒化アルミニウム その場観察

1. 研究開始当初の背景

我々は都市生活を営む上で電力変換素子 の恩恵を被っている。例えば、電気自動車で はLi イオン電池から供給されたDC(直流) 電力をAC(交流)に変換してモーターを駆 動している。また、鉄道やエアコンのように AC-DC-AC変換により交流周波数を 変えて使用するケースもある。この電力変換 はインバータ (コンバータ) システムにより 行われており、その中枢を担うのが半導体パ ワーデバイスである。現在、このパワーデバ イスに Si 材料が用いられているが、変換効 率が悪く(80~90%)、供給電力の一部(10 ~20%)を熱として系外に放出している状況 にある。また、Si の劣った材料特性に起因し て、大電力用途ではデバイス面積を大きくす る必要があるなどの欠点も抱えている。この ため、AC-DC変換時における電力損失の 低減(エネルギの高効率利用)およびデバイ スの小型化の観点から代替材料による素子 の置換が検討されている。現在、鉄道などの 大電力用途では炭化ケイ素 (SiC) 材料への 置換が始まっており、並行してデバイス特性 の改善が試みられている。また、SiC よりも 更に高い変換効率が期待できる窒化ガリウ ム (GaN) 系パワーデバイスの開発も進めら れている。一方、窒化アルミニウム(AIN)系 材料を用いたパワーデバイスは現在プロト タイプが作製されている段階で、GaN 系のそ れより高温動作に優れているなどの基礎デ ータは報告されているが変換効率はまだ他 の材料に追い付いていない。これは、Al(Ga)N 薄膜を堆積し、デバイスを作製するための高 品質かつ低コストの AIN 基板結晶が世の中 に存在しないことに起因する。

2. 研究の目的

本研究課題では、高品質かつ低コストのAIN 単結晶基板の成長技術を確立し、AIN 系パワーデバイス開発の加速に貢献することを目的とする。本研究課題の遂行により産応用に資する AIN 基板結晶の成長技術が存立されれば、ノートPC用のACアダププルで小型化し且つ熱の発生を抑制する道が招ける。また、電気自動車の航続距離が約10%伸びるなど社会生活における利便性の向上が期待される。何より、都市の電力需要の低大の意義/メリットとなる。この最終目標に向けて本研究課題ではデバイス作製用の AIN 基板結晶の新規成長技術の開発を行う。

3. 研究の方法

GaN、AIN などの III 族窒化物半導体は、大気圧下では液相が存在しないため Si インゴットの作製で良く知られている CZ (Czochralski) 法などの融液からの成長法をそのまま適用することができない。そのため、高圧下あるいは溶媒(フラックス、融材)の存在下といった特殊環境下での液相成長法

が検討されている。例えば、Na 溶媒を用 いた溶液 (フラックス) 成長法により 900℃ 程度の比較的低温で GaN 成長が実現してい る。また、AIN では Ga-AI 溶媒を用いた~1300 ℃ での溶液成長が報告されている。 いずれも HVPE における典型的な成長温度 (GaN: ~1050°C、AIN: ~1400°C) より 100~200°C 低 い温度域での成長である。加えて、溶液成長 法は一般に、装置や技術も簡便であり、開発 費の削減が期待できる手法と言える。しかし、 III 族窒化物半導体の従来の溶液成長法は N2 ガスを窒素原料としており、気一液界面にお ける雑晶(多結晶)の形成、溶液中の過飽和 度制御の困難性などが問題となっていた。こ れらの問題点を克服するために、近年、Li₃N (融点:813°C) を窒素原料とする AIN 固体 ソース溶液成長 (Solid-Source Solution Growth; 3SG) 法を開発した[引用文献①]。3SG 法で は粉末の Li₃N を溶解して窒素原料とするた め、気-液界面近傍で最大の窒素濃度(=固 溶度)となる必然性(束縛条件)が無く、装 置設計上の自由度が増すなどの利点がある。

本研究課題では、AIN 溶液成長における初期成長様式を制御し、貫通転位密度の低減を図るためにその場観察装置の開発を行った。本装置では、可視光に対して無色透明の AIN/サファイア(sapphire) テンプレートを用いて基板の裏面側から表面(固一液界面)形状をその場観察している。図1 に AIN 溶液成長におけるその場観察装置の概略図を示す。ここでは外部光源を用いず Li-Al-N 溶液からの熱輻射を利用して観察を行っている。基板材料は低圧 MOVPE(有機金属気相成長) により成膜した膜厚 1 μm の AIN/Sapphire テン

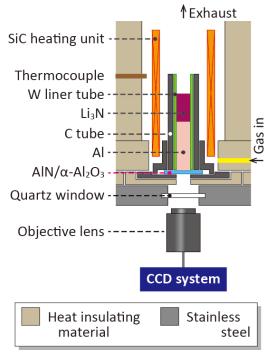


図1 高温固-液界面その場観察装置の概略図。

プレートであり裏面は鏡面研磨処理が施さ れている。カーボン管にタングステン管を挿 入しその中に原料となる Li₃N:Al=1:4 の粉 末を充填している。原料を融点以上の温度で 熱することにより Li-Al-N 溶液と AIN/Sapphire の界面を得る。光学系の構成は 次の通りである。(i)長焦点距離対物レンズ (倍率: 4~28 倍、焦点距離: 32 mm、空間 分解能: 2 μm)、(ii)高解像度 CCD カメラ (500 万画素、ペルチェ冷却:室温-20 ℃)。 (i)、(ii)を合わせた実効的な倍率は約 1000 倍 になる。原料坩堝はSiC ヒーターによる抵抗 加熱により昇温し、固一液界面の 10 cm 直上 の温度をR 熱電対によりモニターしている。 3SG による AlN 成長時は純度 6N の N₂ ガ スを炉内に流している。

4. 研究成果

図1に示すように、AlN/Sapphire テンプレ ートの上に Al 粉末, その上に Li₃N 粉末を配 置している。昇温前は図2に示すように AIN/Sapphire テンプレートを通して AI 粉末 が観察される。成長炉を15℃/min で昇温 したところ熱電対の指示温度が 700 ℃ にな った時に Al 粉末の融解が観察された(図2 (b)参照)。Al の融点が 660 ℃ であり、熱電対 の測温位置が固一液界面から 10 cm 直上であ ることを考えると炉内鉛直方向に約4 °C /cm の温度勾配が生じていることがわかる。Al 粉末の融解後、1350 °C まで昇温した。昇温 後 19 分までは光学像に顕著な変化は見られ ず、19 分経過した後から 2 段階の成長様式 で成長が進行していることが明らかとなっ た。[Process I] 微結晶の凝集体が形成されそ の領域(凝集体の体積)が基板面に沿って2

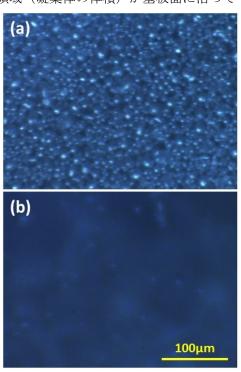


図 2 Al 粉末の光学写真。(a)成長開始 前、(b)融解後。

次元的に膨張する。[Process II] 微結晶の凝集体を覆うようにマクロステップフローによる成長が進行する(図3参照)。ただし、ここでは単結晶ではなく多結晶が成長した。[Process I] は昇温後 19 min から、[Process II] は昇温後 23 min から開始する。成長開始までのタイムラグは Al 原料の上に配置されたLi₃N 原料から N が移動(対流および拡散)して固一液界面に到達するまでに時間を要すことによる。また、窒素原料からの N 供給量が少ない(Al-N の過飽和度が低い)状況下では[Process I] に見られる微結晶の形成が起こり、過飽和度が高くなってくると[Process II] のようなマクロステップフロー

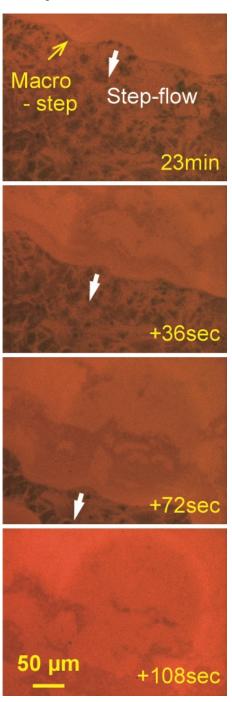


図3 1350 ℃ まで昇温した後の固 – 液界面形状のリアルタイム変化。

による成長が進行すると考えられる。本実験の成長条件では結果として多結晶が形成されたが、高温における固一液界面形状のその場観察に成功した。ここで開発したその場観察装置は、溶液成長における初期成長様式を観察・制御し(成長条件を最適化し)結晶の高品質化を行うための有用な装置となり得ることが示された。

<引用文献>

- ① Y. Kangawa, R. Toki, T. Yayama, B. M. Epelbaum, K. Kakimoto, Appl. Phys. Express 4, 095501, 2011.
- 5. 主な発表論文等 〔雑誌論文〕(計3件)
- ① Y. Kangawa, H. Suetsugu, M. Knetzger, E. Meissner, K. Hazu, S. F. Chichibu, T. Kajiwara, S. Tanaka, Y. Iwasaki, K. Kakimoto, Structural and optical properties of AlN grown by solid source solution growth method, 查読有, Jpn. J. Appl. Phys. 54, 085501, 2015.

http://dx.doi.org/10.7567/JJAP.54.085501

- ② Y. Kangawa, A. Kusaba, H. Sumiyoshi, H. Miyake, M. Boćkowski, K. Kakimoto, Real-time observation system development for high-temperature liquid/solid interfaces and its application to solid-source solution growth of AlN, 查読有, Appl. Phys. Express 8, 065601, 2015.
 - http://dx.doi.org/10.7567/APEX.8.065601
- ③ <u>寒川義裕</u>, 三宅秀人, Michał Boćkowski, 柿本浩一, AlN 溶液成長における固-液界 面その場観察装置の開発, 査読有, 日本 結晶成長学会誌, 42, 232, 2015.

〔学会発表〕(計12件)

- ① Y. Kangawa, H. Miyake, M. Bockowski, K. Kakimoto, Development of in-situ observation system for high-temperature liquid/solid interfaces: application to solid-source solution growth of AlN, Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG-5), 2015. 09. 10, Bologna (Italy).
- ② Y. Kangawa, H. Miyake, M. Bockowski, K. Kakimoto, Development of in situ observation system for liquid/solid interface during solution growth of AlN, Workshop on Ultra-Precision Processing for Wide Bandgap Semiconductors (WUPP2015), 2015. 08. 20, ヒルトン福岡シーホーク(福岡市)【招待講演】.
- ③ H. Sumiyoshi, Y. Kangawa, S. F. Chichibu, M. Knetzger, E. Meissner, Y. Iwasaki, K. Kakimoto, CL studies of AlN/AlN(0001) grown by solid source solution growth

- method, International Workshop on Nitride Semiconductors 2014 (IWN2014), 2014. 08. 26, Wroclaw (Poland).
- ④ Y. Kangawa, S. Nagata, K. Kakimoto, Microstructure of AlN/AlN(0001) grown by solid-source solution growth (3SG) method, 8th International Workshop on Bulk Nitride Semiconductors (IWBNS-VIII), 2013. 10. 01, Kloster Seeon (Germany). 【招待講演】
- ⑤ Y. Kangawa, S. Nagata, B. M. Epelbaum, K. Kakimoto, Dislocation propagation behavior in AlN grown by solid-source solution growth (3SG) method, JSAP-MRS Joint Symposia, 2013. 09. 18, 同志社大学(京都). 【招待講演】
- Y. Kangawa, S. Nagata, B. M. Epelbaum, K. Kakimoto, Influence of growth orientation on microstructure of AlN grown by solid-source solution growth (3SG) method, 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-17), 2013. 08. 14, Warsaw (Poland).

[図書] (計1件)

① <u>寒川義裕</u>, 第 3 編、第 3 章; 固体ソース 溶液成長法~AIN 単結晶成膜を事例とし て~, (株)NTS, ポストシリコン半導体 ー ナノ成膜ダイナミクスと基板・界面効果 ー, pp. 379-390, 2013. ISBN 978-4-86469-059-1

6. 研究組織

(1)研究代表者

寒川 義裕(KANGAWA, Yoshihiro) 九州大学・応用力学研究所・准教授 研究者番号: 90327320

(4)研究協力者

ボコウスキ ミハエル (BOĆKOWSKI, Michał)

ポーランド科学アカデミー・高圧物理学研 究所・教授

マイスナー エルケ (MEISSNER, Elke) フラウンホーファー研究機構・集積システム・デバイス技術研究所・上席研究員